

# 表面貼裝器件 應用注意事項說明

## ▶ 安全注意事項

1. 避免過度彎曲的印刷電路板，以保護電阻的不正常的壓力。
2. 當用烙鐵焊接時，勿將烙鐵頭與貼片電阻本體接觸。當使用高溫的烙鐵焊接時，須盡快完成焊接（接觸時間最大 3 秒 350°C）。
3. 對機械應力應採取適當的措施，以避免損害貼片電阻的電極和保護塗層。注意，不要放錯置貼片電阻的焊接區。不然，可能會發生錫溢。
4. 如果將施加瞬間負載如脈衝，請先評估確認貼片電阻是否適用。永遠不超額定功率使用。不然，貼片電阻的性能和可靠性可能會被損壞。
5. 如果焊點增大，則作用於電阻的機械應力將會增加，因而造成問題，如裂縫和缺陷。請避免使用過多的焊料。
6. 不要震動或用硬工具夾電阻器（例如鉗子和鑷子）。不然，可能傷損電阻器的保護塗層，影響的性能。
7. 不要使用鹵素或其他高活性的助焊劑。不然，殘留物可能會損害電阻器的性能和可靠性。

## ▶ 使用注意事項

1. 小心置放貼片產品，避免由於周邊熱發電子組件的溫度影響，而超過安全溫度範圍。不要安裝在產生熱量的組件或易燃物上，如乙烯塗層。
2. 請注意，非清潔焊料，含鹵素的高活性助焊劑，或水溶性助焊劑，可能損壞產品的性能或可靠性。
3. 慎選焊接後請洗用的清潔劑。不適合的溶劑，可能損壞產品的性能或可靠性。特別是，在使用水或水溶性清洗劑，應注意不要留下水的殘留物。不然，絕緣性能可能會變差。
4. 貼片產品不適合下面的特殊使用條件。在使用產品前，請仔細核對其品質和性能的影響，並確定他們是否可以應用。
  - \* 在含鹽的空氣或空氣中含有高濃度的腐蝕性氣體，如 SO<sub>2</sub>, Cl<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S, NH<sub>3</sub>, or NO<sub>2</sub>。
  - \* 請採取措施，避免靜電環境。小型組件較為敏感
  - \* 避免任何強大的電磁波環境下
  - \* 使產品導致結露的環境中
  - \* 在液體，例如水，石油，化工，或有機溶劑
  - \* 在陽光直接照射，在戶外，或塵埃

## ▶ 儲存注意事項

儲存在溫度 5°C ~ 35°C，相對濕度 45% 至 85%，及良好的包裝可以保證貼片產品的性能，和可焊性。